公司代码：688498　　公司简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。截至2026年3月23日，公司总股本85,947,726股，扣除目前回购专户的股份余额275,169股后参与分配股数共85,672,557股，以此计算合计拟派发现金红利59,970,789.90元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度已分配的现金红利25,648,673.10元)总额85,619,463.00元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.84%。

公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至2026年3月23日，公司总股本85,947,726股，本次转增股本后，公司的总股本为124,500,377股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入所致)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份275,169股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

以上利润分配及资本公积转增股本方案经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程颖	吴晶
联系地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号	陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号
电话	029-38011198	029-38011198
传真	029-38011198	029-38011198
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，公司主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G、200G以及更高速率的DFB、EML激光器系列产品和50mW、70mW、100mW等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，公司产品涵盖1550波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

通过持续的研发投入构建差异化竞争优势，公司从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展成为国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

应用领域			速率	产品类型
电信市场类	光纤接入	光纤接入EPON	2.5G	1310nm FP
		光纤接入GPON	2.5G	1310nm DFB
			2.5G	1490nm DFB
		光纤接入10G PON	2.5G	1270nm DFB
			10G	1270nm DFB
			10G	1577nm DFB
			10G	1577nm EML
			10G	1577nm w/SOA
		光纤接入25G/50G PON	25G	1300nm DFB
			25G	1286nm DFB
			25G	1358nm EML & 1358nm w/SOA EML
			50G	1286/1342nm EML & 1286/1342nm w/SOA EML
	移动通信网络	4G移动通信网络	10G	1310nm FP
			10G	1310nm DFB
			10G	1310nm Antireflection DFB
			10G	1270～1570nm CWDM16 DFB
		5G移动通信网络	25G	1310nm FP
			25G	10G overclock 1270～1370nm CWDM6 DFB
			25G	1270/1330nm DFB
			25G	1310nm DFB
			25G	1270～1370nm CWDM6 DFB
			25G	LWDM12 Channel DFB
			25G	MWDM12 Channel DFB
			50G	1270～1370nm CWDM6 DFB
数据中心类	数据中心		10G	1270～1330nm CWDM4 DFB
			25G	1270～1330nm CWDM4 DFB
			25G	LWDM4 Channel DFB
			50G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 DFB
			100G	1270～1330nm CWDM4 PAM4 EML
			100G	1304/1307/1309/1311nm Narrow LWDM PAM4 EML
			200G	1270～1330 CWDM4 PAM4 Single & Differential Drive EML
			CW	100mW 1310nm CW DFB
			CW	100mW CWDM4 CW DFB
			CW	70mW CWDM4/8 CW DFB
			CW	70mW 1310nm CW DFB
			CW	70Mw LWDM4 CW DFB
			CW	50mW 1310nm CW DFB
			CW	25mW CWDM4 CW DFB
车载激光雷达及传感			/	1550nm Pulse DFB
			/	CH4 sensor

注：

1、2.5G、10G、25G、50G、100G、200G代表激光器芯片的传输速率；CWDM、LWDM、MWDM代表可应用于波分复用网络的激光器芯片；PAM4代表可应用于PAM4脉冲调制技术的激光器芯片；

2、报告期内，公司主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，公司会将激光器芯片封装后进行销售。

2.2 主要经营模式

1、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划，将接收到的订单需求反馈给生产与运营部，协调产品研发、生产、交付、质量等服务工作，同时承担跟单、售后、技术支持等工作。

新产品及客户导入方面，由于光芯片产品设计参数、性能指标多，公司市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流，研发中心在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作，然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试，并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后，客户会小批量下单采购，并在多批次生产合格后，转入批量采购。公司的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。

2、采购模式

每月月末，采购部根据生产与运营部提报的次月生产计划及安全库存数据，制定配套的生产原物料采购计划(含需求预测)。采购员依据该计划向合格供应商下达采购订单(PO)，明确技术规格、交货周期及相关合作条款；同时通过搭建供应商管理库存(VMI)机制，保障关键物料供应稳定。

进料检验工作由IQC部门负责，该部门严格依据可接受质量水平(AQL)标准开展检验，并运用统计过程控制(SPC)方法监控物料关键质量特性，最终出具的检验分析报告(COA)，是物料入库放行的核心依据。物料到货后，由仓管科核对到货单与采购订单的物料数量；财务部负责执行采购款项的最终结算工作。

研发、厂务、行政等非生产部门，需结合公司经营需求制定各自采购计划，提前提交采购部审核，审核通过后由采购部统一组织采购。

在供应商管理层面，公司已建立健全的供应商认证及全生命周期管理流程：对新供应商开展资质评估与实地考察，对其提供的样品进行严格验证，通过评审的供应商纳入《合格供方名单》。同时，公司对供应商实施动态绩效考核与分级管理，按需推进物料替代方案管理及供应商稽核工作，确保采购质量符合ISO9001/14001体系要求，采购活动全面达成质量、成本、交付、服务、环保(QCDS)综合目标。

3、生产模式

公司生产激光器芯片属于IDM模式，掌握芯片设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术，拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力，公司的IDM模式能够缩短产品开发周期，实现光芯片制造的自主可控，快速响应客户并高效提供相应解决方案，能够迅速地应对动态市场需求。

公司生产以市场需求为导向，生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。公司根据年度销售策略进行产能评估，提前适当备货以应对需求高峰，保持库存的适度水平，减轻生产压力。

4、研发模式

公司研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础，新产品研发流程以研发中心《设计和开发控制程序》体系进行管理，从立项开始先后经历6个阶段，主要包括：立项、设计输入输出、工程验证测试(EVT)、设计验证测试(DVT)、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化(PVT)等阶段，各阶段要求满足后进入下一阶段，具体如下：

(1)立项阶段

市场与销售部根据客户及市场需求，提出新项目立项申请，填写《项目研发建议书》，并提交市场与销售部、研发中心及总经理共同评审。项目评审通过后，指定项目负责人制作项目可行性分析，包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施，确定参与人员、明确客户指标需求等。

(2)设计输入输出阶段

项目负责人根据立项阶段资料，制作设计开发阶段指导文件及流程，包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。

(3)工程验证测试阶段(EVT)

研发中心根据《设计和开发控制程序》要求进行投片，参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制，在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求，研发项目团队总结样品试制过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，获得批准后进行下轮样品试制，直到满足客户需求后可转入下一阶段。

(4)设计验证测试阶段(DVT)

研发中心根据投片数量进行设计验证测试，对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设计验证测试结束若无法满足客户需求，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，从上一阶段的工程验证测试(EVT)开始开发，直到满足客户需求并通过验证。

(5)研发转生产培训考核阶段

研发转生产培训考核阶段，研发中心提供给生产与运营部相关资料，包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等，并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核，通过评审后方可转入下个阶段。

(6)批量过程验证测试优化阶段(PVT)

批量过程验证测试优化阶段(PVT)，生产与运营部接收研发转生产阶段文件后，评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素，确认具备量产能力后，制定并组织实施生产计划，投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，直到达到预期目标并通过验证。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段及基本特点

随着全球信息互联规模不断扩大，人工智能等技术的兴起，光电信息技术正在被进一步广泛应用。在这种趋势下，光芯片的下游应用场景不断扩展，需求量不断增加，同时对光芯片的速率、功率、传输距离也提出更高的要求。目前在电信市场、数据中心市场，光芯片都得到了较为广泛的应用，其中电信市场又可以细分为光纤接入和移动通信两个细分领域。

电信市场：5G、千兆光纤网络等新型基础设施建设进一步完善。在光纤接入市场：截至2025年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.91亿户，全年净增2,099万户。1000Mbps及以上接入速率的用户为2.38亿户，全年净增3,157万户，占总用户数的34.5%，占比较上年末提高3.6个百分点。截至2025年底，固定互联网宽带接入端口数达到12.51亿个，比上年末净增4,877万个。其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到12.1亿个，比上年末净增5,030万个，占比由上年末的96.5%提升至96.8%。截至2025年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3,162万个，比上年末净增341.9万个。在无线通信领域，5G网络建设覆盖持续深化。截至2025年底，全国移动电话基站总数达1,287万个，比上年末净增22.7万个。其中，4G基站为719.2万个，比上年末净增8万个。5G基站为483.8万个，比上年末净增58.8万个，5G基站占移动电话基站总数达37.6%，占比较上年末提升4个百分点。其中，具备5G RedCap接入能力的基站数达206.4万个，占5G基站的42.7%。随着无线和光纤接入部署逐步进入成熟期，下一代技术逐步开始布局。光纤接入领域开始向“万兆”加速。作为ITU-T定义的下一代PON技术，50G PON比10G PON带宽提升了5倍、时延降低了100倍，具备提供确定性业务体验的能力。万兆光网试点逐步落地，拉动了50G PON的市场需求。同时，由于5G-A在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，能更好地匹配人联、物联、车联、高端制造、感知等场景，运营商也逐步推进其商用部署或组网试点。相关技术的成熟与推广，有望对相关的产业链形成拉动作用。整体来看，电信市场需求具有较强的稳定性和持续性，其建设节奏会受到技术迭代升级等因素的影响。

数据中心市场：随着AI技术规模化落地、大模型迭代及新兴应用爆发，算力需求指数级攀升，驱动数据中心高速率光模块需求爆发式增长。2025年后，国内外CSP加速AI基础设施投资，光模块出货量激增同时拉动光芯片需求。速率方面，2025年1.6T光模块已批量出货，2026年迈入商业化爆发期。算力提升推动业界对光模块功耗、散热、成本要求更严苛，低功耗、小型化、集成化成为核心发展主线。技术上，硅光技术在高速率模块中渗透率快速提升，拉动了光芯片领域CW产品的需求增长；CPO、NPO等新型的封装技术持续推进，成为光互联领域新增量。由于光互联的需求增长，当前光芯片存在短期产能缺口。整体而言，AI是光模块(光芯片)行业核心驱动力，增长确定性强。

(2)主要技术门槛

面向更高速率、更高功率、更长传输距离需求的光芯片，其技术研发与工艺设计面临着极高的开发难度和行业门槛。首先，随着市场对光芯片性能需求的持续提升，芯片结构设计的精度要求已达到极高标准，其技术研发与工艺开发需深度融合高速射频电路与电子学、微波导光学、半导体量子力学、半导体材料学等多个前沿学科，通过多维度技术协同，设计出兼具精度与尺寸要求的芯片结构，任何单一学科技术的短板都将制约研发进程。其次，生产工艺的高稳定性与高成熟度门槛。激光器芯片的生产流程极为复杂，需历经几十至几百道精密工序，每一道工序的参数偏差、操作误差都将直接影响产品最终的光电性能与长期可靠性，这就对生产线的工艺成熟度、流程稳定性以及过程管控能力提出了严苛要求，需实现全流程的精准把控，门槛显著高于普通半导体器件。此外，高速率产品的关键结构开发壁垒尤为突出。相较于中低速率光芯片，高速率激光器芯片需在量子阱有源区、光栅层结构区、模斑转化器区域、光波导结构区、电流限制结构区、高频电极结构、谐振腔反射膜等多个关键结构的设计与开发中，综合平衡光电特性、产品可靠性与制备工艺可行性等相互制约的核心因素，既要保障各结构的独立性能达标，又要实现整体协同适配，进一步提升了技术开发的难度与行业壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。通过研发、市场、服务、产品等多个维度的协同发展，公司已经获得国内客户的认可，并从电信市场收入为主的光芯片供应商，逐步发展国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

在电信市场中，目前所需的2.5G、10G激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大，公司凭借长期技术积累实现激光器光源发散角更小、抗反射光能力更强等差异化特性，为光模块厂商提供全波段、多品类产品，同时提供更低成本的集成方案，实现差异化竞争；25G/50G PON接入网对光芯片的要求也将进一步提升，大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛，公司已开发相应的集成技术与光放大器集成技术平台，适配高速接入网的需求，使公司能够快速满足下游客户25G/50G PON的需求，研发出满足客户需求的光芯片产品，在下一代高速PON需求迭代过程中确保行业地位。

在数据中心市场中，尤其是以人工智能为代表的应用拉动了400G/800G、1.6T或以上高速光模块的需求增加，进而带动了高速率、大功率的芯片需求，比如主要为100G PAM4 EML光芯片、70mW、100mW大功率激光器等。目前数据中心市场仍以海外供应商为主。公司基于多年在光芯片领域的研发和生产积累，已推出相应的高速EML、大功率激光器产品，无论是单波或是多波长的CWDM、LWDM需求，来适配相关的高速光模块的需求，且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。目前，公司在AI数据中心市场实现销售突破。尤其是硅光模块解决方案所需的全系列大功率CW激光器产品，2025年面向高速可插拔硅光模块的CW芯片产品已实现大批量的出货，奠定了公司在该领域较为领先的行业地位。同时，人工智能的发展导致数据中心领域光互联的技术迭代较快，更高速率、不同封装方式的需求均在快速发展，公司目前在数据中心领域实现了光芯片大批量出货的基础，相关技术、商务、产能储备处于行业领先地位，这些因素将有助于公司把握新一代的需求，巩固行业地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)硅光技术已成为算力场景降本增效的核心方案，渗透率持续加速提升

降本、降功耗、增效仍是全球算力发展的核心诉求，尤其随着AI大模型向万亿参数级迭代，算力需求爆发式增长，直接推动光模块速率与数量需求激增，进一步凸显硅光技术的核心优势，客户接受度已实现实质性提升，成为行业主流选择之一。硅光子技术基于硅和硅基材底材料，依托现有CMOS工艺实现光器件的开发与集成，契合光模块规模化、低成本生产需求，适配AI数据中心短距高带宽场景的核心需求，相较于传统方案可实现功耗降低与更高的集成度。从当前渗透率来看，硅光方案在400G/800G/1.6T光模块中已形成规模化应用，且头部厂商硅光方案占比持续提升。在硅光方案中，CW激光器芯片作为外置核心光源，硅基芯片承担速率调制功能。未来，CW大功率激光器芯片的性能要求进一步提高，需同时具备更大功率、高耦合效率、宽工作温度的核心指标。

(2)关注CPO、NPO等新技术的演进

随着单通道速率提升，电链路距离越长损耗越大，需要将光引擎更靠近交换芯片。因此，CPO/NPO等新一代封装技术缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，从而帮助电信号在芯片和引擎之间更快地传输，减少尺寸，提高效率，降低功耗。从技术路径来看，以CPO交换机为例，其中CW光源单颗价值量与功率需求均持续提升，进一步带动大功率CW激光器芯片需求增长。在应用场景上看，CPO/NPO在柜内的应用，也将带来新的需求增长。但目前CPO/NPO仍面临成本、解耦程度低、产业不成熟等问题，仍需产业链上下游协同发力突破。

(3)光芯片下游应用市场不断拓展

光芯片的应用领域正在不断拓展。在传感领域，如环境监测、气体检测，光芯片被用作传感器，能够检测光信号并转换为电信号，用于数据采集和分析。在汽车领域，随着传统乘用车的电动化、智能化发展，高级别的辅助驾驶技术逐步普及，核心传感器件激光雷达的应用规模将会增大。基于砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)的光芯片作为激光雷达的核心部件，其未来的市场需求将会不断增加。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,577,488,956.70	2,147,544,868.83	20.02	2,236,682,340.61
归属于上市公司股东的净资产	2,332,284,683.21	2,072,766,453.62	12.52	2,116,687,842.73
营业收入	601,434,509.56	252,172,673.21	138.50	144,403,649.04
利润总额	213,772,158.54	-15,312,303.55	/	18,153,315.49
归属于上市公司股东的净利润	190,924,031.75	-6,133,875.94	/	19,479,815.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,222,369.40	-11,426,044.66	/	-238,669.33
经营活动产生的现金流量净额	150,235,546.02	18,960,995.49	692.34	-17,399,733.48
加权平均净资产收益率(%)	8.68	-0.29	增加8.97个百分点	0.92
基本每股收益(元／股)	2.24	-0.07	/	0.27
稀释每股收益(元／股)	2.23	-0.07	/	0.27
研发投入占营业收入的比例(%)	13.44	21.62	减少8.18个百分点	21.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	84,401,229.37	120,549,649.86	178,298,608.24	218,185,022.09
归属于上市公司股东的净利润	14,320,164.13	31,943,745.13	59,628,884.23	85,031,238.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,970,919.69	31,406,441.75	51,385,020.86	70,459,987.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,461,966.72	64,241,014.87	8,158,338.89	83,298,158.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,299
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,388
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
ZHANG XINGANG	12,480	10,575,438	12.30		无		境外自然人
秦燕生		4,604,859	5.36		无		境内自然人
秦卫星		4,478,859	5.21		无		境内自然人
苏州瑞璞股权投资管理合伙企业(有限合伙)－宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	-95,200	3,294,418	3.83		无		其他
张欣颖		2,944,053	3.43		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	696,772	1,908,657	2.22		无		其他
陕西科讯投资管理合伙企业(有限合伙)－陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	-863,234	1,503,991	1.75		无		其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	536,532	1,371,452	1.60		无		其他
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	84,421	1,367,284	1.59		无		其他
陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业(有限合伙)		1,260,000	1.47		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、ZHANG XINGANG和张欣颖系兄妹关系；2、秦燕生和秦卫星系兄弟关系；3、ZHANG XINGANG与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人；4、ZHANG XINGANG与欣芯聚源为一致行动人；5、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

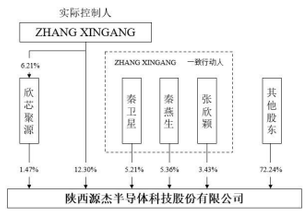
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

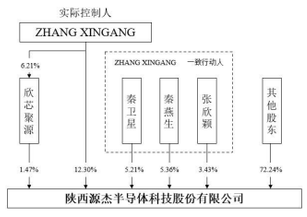
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入60,143.45万元，同比增加138.50%；归属于母公司所有者的净利润19,092.40万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,722.24万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688498
公司简称	源杰科技
公司名称	陕西源杰半导体科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告遵循《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》，根据重要性、量化、平衡及一致性的原则编写，并参考全球可持续发展标准委员会(GSSB)GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》及联合国可持续发展目标(SDGs)进行编制

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略委员会及ESG工作小组。 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG工作小组总结ESG工作中的问题和成果，及时向战略委员会反馈ESG工作情况，提出合理化建议；战略委员会对公司ESG年度目标、计划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议；董事会为最高决策机构，审议和批准公司的ESG年度目标、计划。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《陕西源杰半导体科技股份有限公司ESG管理办法》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	合法合规经营 科技创新 环境保护 当地就业 商业贿赂及反贪污 安全生产	信息披露 调研考察 座谈会 工作汇报
股东/投资者/债权人	保障股东权益 资产保值增值 公司治理 投资回报 信息披露 风险管理 反不正当竞争 应对气候变化	股东会 投资者交流会及调研 业绩说明会 信息披露 上证“e互动”平台 投资者邮箱 投资者热线
客户	研发创新 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 客户服务 知识产权保护	官网 产品调研反馈 客户满意度调查 展会 客户拜访/会谈
供应商	供应链管理 利益相关方沟通 互利共赢	现场调研 供应商会议与审核 供应商合同与协议 日常沟通
员工	平等雇佣 薪酬福利 员工权益保障 人才培训发展 职业健康与安全 人文关怀	员工培训 员工满意度调查 员工活动 投诉邮箱

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	排放物与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
2	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
4	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
5	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
6	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	员工	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
8	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
9	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
11	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
12	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
13	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
14	利益相关方沟通	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
15	知识产权管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
16	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引1》)规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、循环经济、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争议题，在财务重要性及影响重要性层面均不具备高度重要性(或重要性较低)。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2026-018

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2021年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2638号)批准注册申请，并经上海证券交易所同意，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除不含税的发行费用131,222,672.46元，公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2022]第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司累计实际使用募集资金1,190,688,646.69元，其中以前年度累计使用811,721,740.00元，2025年度使用378,966,906.69元(包括置换预先投入金额88,549,843.49元)，尚未使用的募集资金金额为225,944,580.23元(其中包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额计37,955,899.38元)。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为225,944,580.23元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年12月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额(含发行费用)	1,509,900,000.00
其中：超募资金金额	427,226,800.04
减：发行费用(不含增值税)	131,222,672.46
二、募集资金净额	1,378,677,327.54
减：	-
以前年度已使用金额